

# フレキシ印刷用 導電性銅ナノインク

Conductive Cu Nano Ink for Flexographic printing

## 特長 Features

- 1 紙、PET、PI、PEN、PC、ガラス等の基材上で回路形成が可能です。  
Minute Cu circuit patterns can be formed on polyimide(PI), glass, silicon substrates, PET and paper with the Cu nano ink.
- 2 純銅に近い比抵抗の皮膜が得られます。  
The resistivity of Cu film is close to that of bulk copper.
- 3 耐マイグレーション性に優れます。  
Superior migration resistance.

## インク特性 Properties of ink

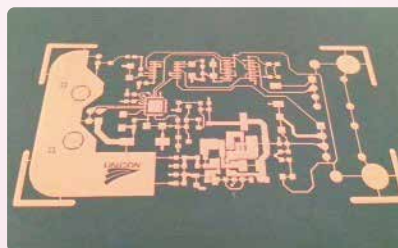
型番	Applicable substrate	<b>F-03B</b>	
Cu濃度 (mass%)	Cu content	65 - 75	
平均粒径 (nm)	M.D.	80	
粘度 (mPa・s)	Viscosity	100 - 300	
体積抵抗率 ( $\mu\Omega \cdot \text{cm}$ )	Resistivity	①キセノンフラッシュランプによる焼成 Sintering by Xenon flash lamp ・4-5 (vs.PI and glass) ・7-9 (vs.paper)	②ギ酸リフロー焼成 (200℃ 10min) Vacuum reflow in formic acid atmosphere ・PI: 6-7 (vs.PI)
密着性	Adhesion	テープ剥離無し (vs. PI and glass) No peeling vs. PI and glass	

## フレキシ印刷 Flexographic printing

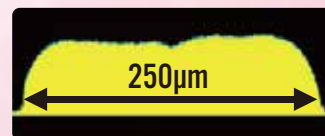


RFタグ (紙)

膜厚 Thickness of the film : 約1 $\mu\text{m}$



Hard coat PET上の銅回路と配線形状  
Cu circuit pattern on HCPET and line profile



膜厚 Thickness of the film : 0.8 $\mu\text{m}$   
線幅 Line width : 250 $\mu\text{m}$

本資料に記載する数値は当社の試験に基づく実測値であり、保証値ではありません。  
We do not give any guarantee concerning technical values on this catalog.

